



S-Takaya电子工业株式会社

总公司 719-0301 日本冈山县浅口郡里庄町里见3121-1
电话：(+81)865-64-4131 传真：(+81)865-64-4474

详情请点阅以下网址
<https://www.s-takaya.co.jp>

S-takaya

搜索



Contribute To The Future Of Society

凭借我们独特的 技术和知识 利用最先 端的技术， 对社会的未 来有所贡献。

“S” 包含

公司名称中的“S”反应着多样化的时代，赋予着许多含义。
因此，我们创办(sta rt)了这样的公司。



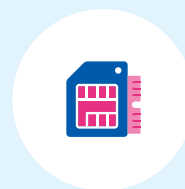
SATOSHO
里庄町



SURPRISE
惊喜



SMART
智慧



SPECIAL
独一无二



SEEK
追求



SPICES
刺激



SMILE
微笑



SCOOP
欢乐

1979年8月 — 2021年10月

更名为“S-TAKAYA ELECTRO NICS INDUSTRY CO.,LTD.”

Business 事业介绍

我们开发独创的LSI装置和模块并构建生产系统

我们S-TAKAYA持续藉由LSI (大规模集成电路) 装置和模块的开发和制造为信息社会的发展做出贡献。

在不断发展的社会中, 客户的要求是多样化的。

我们制造独创的 LSI 设备和产品、构建生产系统以及制造定制设备和治具等, 不断创造和提供各种解决方案。

SERVICE



LSI Device和模块

LSI DEVICE / MODULE

我们制造和检查各种类型的模块, BGA、COF、图像感应器等。用于车载、医疗和智慧手机。



雷达模块

RADAR MODULE

我们根据客户的需求和环境提供从雷达模块的设计开发到量产的定制服务。



产业用设备的开发贩卖

DEVELOPMENT OF AUTOMATION EQUIPMENT

我们提供客户制造时最合适的自动机台, 省人化/省力化/小型化及研究开发时所需的特殊设备, 也能做原厂委托设计的服务, 请随时与我们联系。



环保产品

ENVIRONMENTAL

我们提供环保的产品和服务。

Reason 选择S-TAKAYA的理由

持续响应客户需求

本公司以创业40多年的历史累积的各种半导体组件的制造技术和专业知识, 快速并有诚意的满足客户的需求。



LSI Device Module

LSI Device/
模块

我们凭借丰富的经验和技術能力满足客户各式各样的需求。

随着电子化的急剧发展，LSI Device 和模块需要具有更高的功能和更小的尺寸。
我们为了满足这些市场需求，融合技术、设备和系统，安装最新设备，
构建高效的生产体制，衍生出最新的LSI Device 和模块。

生产体制

我们可以提供从晶圆测试到模块安装的一站式服务。凭借我们独特的技术，我们支持客户构建所需的生产体制。

01 客户提供需求



我们根据客户的需求生产产品。
欢迎随时与我们联系。

02 晶圆测试



产品晶圆测试。

03 研磨/切割

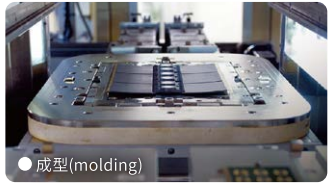
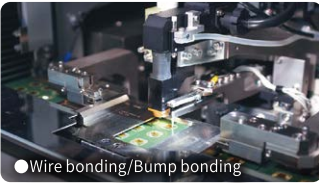


背面研磨，雷射开槽，晶圆切割。

04 LSI Device 的后段组装



我们独特的技术组装。



05 模块组装



进行产品的安装并进行确认。

06 最终测试/外观检查



出货前测试详细检查性能。

07 出货



从下单到出货的一站式服务。

OP1 分析解析服务

OP2 环境RA试验

产品应用领域

- 相机模组
图像传感器
- 特殊mold成型
(透明胶模)
- TAIKO® wafer的
rib除去、dicing
- 模块/MCM
- 特殊成型
(部分外露模具)
- Chip full test
- COF
(Chip On Film)
- 特殊成型
(预成型空心包装)
- chip的全数6面外观检查及
KGD (Known Good Die)
- BGA (Ball Grid Array) /
塑料封装
- wire bump、dicing 及
自动测定检查

Radarmodule

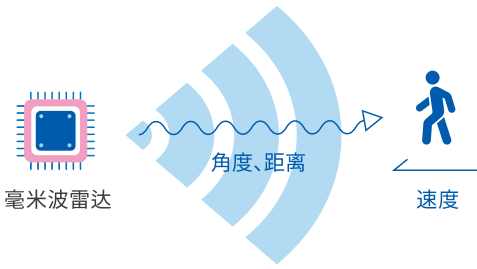
雷达模块

我们拥有从开发到量产的一站式的技术能力

雷达模块可一气呵成地满足客户的式样要求。

雷达的优势

30GHz-300GHz频率的毫米波具有较强的直线特性，
受雨雾等外界环境因素的影响较小。
利用这种毫米波进行传递的设备称为毫米波雷达。
利用毫米波雷达，可以获得物体的距离、角度、速度等数据。



	雷达	红外线	超音波	相机	LIDAR
近距离检测 (2m以下)	●	●	●	●	●
中距离检测 (2-30m)	●	●		●	●
远距离检测 (大于30m)	●				●
距离检测	●	●		●	●
速度检测	●		●		●
角度检测	●	●		●	●
耐环境性	●				
产品设计自由	●				
尺寸	●	●	●	●	
价格	●	●	●	●	

毫米波雷达可以用在什么地方？



防范措施

可以透过辨识人物和距离而启动警报器及监视器，是今后备受瞩目的防范措施。



安全侦测

在厕所、浴室等难以安装监视器的地方，在考虑到隐私的情况下，可以检测突发疾病和异常情况的发生。



婴儿和护理场所的监控

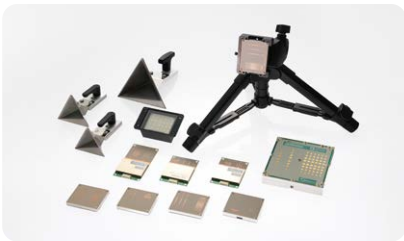
它可以透过侦测床上的呼吸和脉搏来识别病情状况的变化，防止窒息等事故的发生。



节能装置

透过灯光和家电的结合，雷达可以借由透过检测人体来自动控制电源，达到节能省电的效果。

关于各种评估元件



可以借由使用评估元件立即开始评估您的雷达模块。透过使用评估元件找出问题，可以降低试作生产和评估的成本。

评估元件系列

系列	MMIC	频率	距离	速度	角度	转量※1
ST24ZS2系列	Infineon Technologies	24GHz	●			▲
T14RE系列	Texas Instruments	79GHz	●	●	●	●
T68PE系列	Texas Instruments	60GHz	●	●	●	●
T68PE2系列	Texas Instruments	60GHz	●	●	●	●
T18PE系列	Texas Instruments	76GHz、79GHz	●	●	●	●
Atlas24系列	Analog Devices	24GHz	●	●	●	▲
Atlas7xG系列	Analog Devices	76GHz、79GHz	●	●	●	▲
Eris系列	NXP Semiconductors	79GHz	●	●	●	▲
Eris2系列	NXP Semiconductors	76GHz、79GHz	●	●	●	▲
Athena60系列	Asahi Kasei Microdevices Corporation	60GHz	●	●	●	●
Athena79系列	Asahi Kasei Microdevices Corporation	79GHz	●	●	●	▲

※1 ▲为可客制量产

Facility & Original product

产业用设备的
开发贩卖

我们为制造现场的创新做出贡献

我们用半导体组装现场所培育出的感性，给与顾客的制造时最合适的自动化设备。

客制化测试处理器DX系列

这是一种全自动测试处理器，运输部和检查部为分离的结构。

我们还可以根据摄像头模块的检测内容提供各种测试元件。



测试元件使用实例

我们根据客户的工作和检查环境客制化测试元件。

DX1327

用于相机模块的行程行为测量

- 3阶段 (6dut) 类型
- 测试元件
VCM行程检查/OIS (光学防手震) 特性检查



DX1533

用于摄像头模块向下特性检测

- 3阶段 (6dut) 类型
- 测试元件
无穷大特性检查/黑痕检查/白痕检查



DX2299

用于超广角摄像头模块

- 2阶段 (4dut) 类型
- 测试元件
光学中心检查/黑痕检查



- 可以根据各种作业和检查内容配置测试元件。
- 其他的package可以在洽谈后提出我们的方案。(CSP/BGA/QFN/QFP等)
- 作业输送段的标准化
- Handler尺寸: W1760 x D1230 x H2280 (mm)
- 测试元件尺寸: W 940 x D700 x H1000 (mm)
- 处理能力: 300 - 500 (UPH)
※这取决于测试元件和检查细节。

其他设备开发



摄像头模块全自动测试机



通用loader/Unloader



雷射焊锡机



复合胶涂布INLINE机

Environmental

环保产品

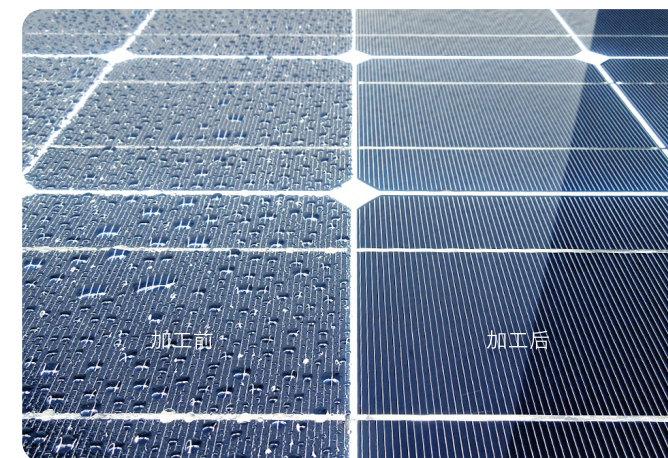
为了留给未来的下一代“美丽的地球”，我们提出了我们可以做的事情

太阳能板清洁



PV Iron Remover (太阳能板除铁剂)

PV Iron Remover可有效去除囤积在太阳能板上的铁粉。



PV Hydro Coat (太阳能板涂层)

PV Hydro Coat有效利用雨水，防止太阳能板表面污垢堆积导致发电量下降。



PV scale remover

此为能将附着在太阳能板上混有scale,铁粉与矿物质的顽强污垢去除的清洁剂。



PV SP cleaner

此为能去除树液·花粉·鸟粪·煤烟等有机物脏污的清洁剂。



SustainabilitySDGs

我们透过环保制造实现碳中和

永续发展目标活动

01 ENVIRONMENT 善待地球

我们基于ISO14001（持续获得认证20年）从选材制造到废弃的过程对环境的影响最小化，致力于实现净零排放。

02 AFFLUENT 迈向富裕的社会

我们以拥有40多年历史技术为基础，制造各种模块产品，为丰富的信息社会做出贡献，这些产品能够符合目前这个多样化的时代。

03 SAFE AND RELIABLE 迈向一个安全和安心的社会

我们透过开发和利用可应用于医疗、防灾和车辆等各种与人们生活息息相关的模块产品，为建立安全、安心的社会做出贡献。

CSR活动

在S-TAKAYA，根据我们的公司座右铭和使命宣言，所有员工都遵守公司和员工的行为准则，促进健康的商业活动，为社会的永续发展做出贡献。为实现此目标，我们不仅要遵守法律，还要履行我们作为优秀企业公民的社会责任，并与所有相关人员建立信任关系，因而提升公司价值。

在S-TAKAYA的CSR活动中，遵循全球准则和原则。
ISO26000《企业社会责任全球指南》/JIS Z26000《社会责任指南》/
SDGs《永续发展目标》/RBA《责任商业联盟》等行业行为准则

各种政策

环境政策

由于S-TAKAYA开发、设计、制造和销售半导体、电子零件、电器电子机械器具和相关产品，我们有责任制造对地球环境友善的产品。我们根据我们的行为准则和基本环境理念致力于环境保护活动。

质量方针

“秉持着质量第一的理念”
Quality First in Heart and Mind

信息安全政策

S-TAKAYA位于自然灾害较少的冈山县，生产和检查各种封装的IC和LSI设备产品。此外，我们利用多年积累的专业知识开发、制造和销售我们独特的产品和电气和电子设备。在我们的业务中，每天都需要对信息进行安全处理，尤其需要加强对生产管理系统、客户信息和技术信息的信息安全管理。为了通过半导体设备产品的开发和制造继续为信息社会的发展做出贡献，我们引入了ISMS并实践了高度安全的管理，并坚持以下方针来持续改进。

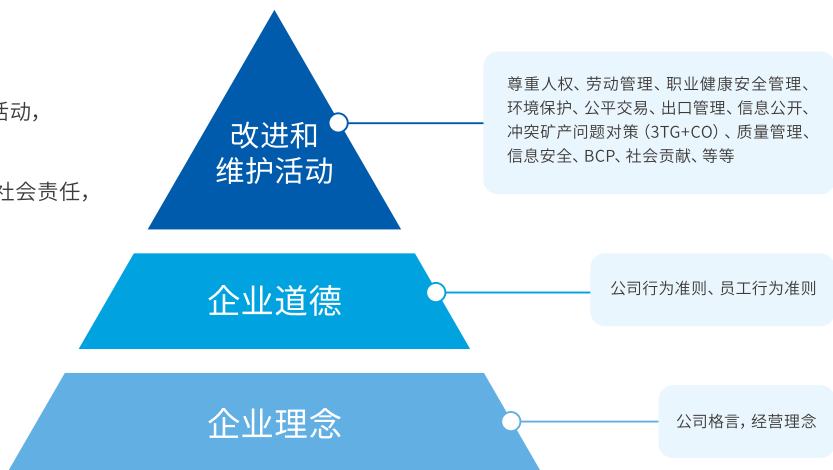


04 CREATING A WORKPLACE 建立有工作意义的职场环境

我们通过保障健康的工作环境和制度，为员工提供技能提升的教育机会，推动工作方式改革，创造和发展有工作意义的职场。

05 REGIONAL CONTRIBUTION 为社区贡献

我们继续积极招募当地人才，与当地企业合作，努力开展当地志愿者工作，为实现可持续发展的区域社区做出贡献。



Company公司简介

来自总裁的问候

建设丰富的生活，创造有价值的职场，以实现舒适的社会为目标

自1979年成立以来，秉持着这些座右铭和使命宣言，我们持续不断地为LSI设备和模块制造商为社会的永续发展做出贡献。2000年代初，随着国内厂商加速全球化，我们将业务版图扩展到海外。凭借多年经验累积的技术能力，我们将公司发展成为世界最高水平的相机模块制造商。因此，我们成功地与国内外市场的领先公司建立了合作业务关系。我们制造业周围的环境一直面临困难，但是，我们相信“日本制造”的重要性一定会再次受瞩目。

我们将继续强调“质量第一”，并通过多元化管理来提高我们的可靠性和公司价值。这旨在提高我们的竞争力，实现理想的公司，并与所有利益相关者共同成长。我们公司和全体员工，借由重视这种商业精神不断发展壮大，我们不断发展我们的业务多方位，愿意接受新时代和新要求的挑战。

Futoshi YUNOKI, 总裁

公司简介



总公司

- 公司名称
S-TAKAYA ELECTRONICS INDUSTRY CO.,LTD.
- 设立
1979年8月15日
- 总裁
柚木太志
- 资本额
1亿日元
- 员工
555人（截至2024年4月）
- 销售收入
97.1亿日元（2024年3月）
- 产品与服务
半导体device・模组产品及产业用设备的开发・制造・贩卖
雷达模块的设计・开发・制造
- 地点
〒719-0301
冈山县浅口郡里庄町里见3121-1
电话：+81-865-64-4131
传真：+81-865-64-4474



相关企业

- 公司名称
SAIGON STEC CO.,LTD.
- 设立
2007年9月
- 资本额
6,100,000美元
（夏普公司51%，S-TAKAYA ELECTRONICS INDUSTRY CO.,LTD. 49%）
- 产品与服务
摄像头模组组装/检测
- 地点
越南社会主义共和国平阳省 VSIPII 工业园区
电话：+84-274-363-5290
传真：+84-274-363-5295



历史

1979

- | | | |
|-------|-----|----------------|
| 1979年 | 8月 | 设立资本额2.5亿日元 |
| 1980年 | 4月 | 开始IC/LSI封装组装测试 |
| 1981年 | 6月 | 增资至2.8亿日元 |
| | 12月 | 开始晶圆测试 |
| 1983年 | 3月 | 第二栋大楼竣工并开始营运 |
| | 4月 | 开始TCP生产 |
| 1984年 | 6月 | 增资至3亿日元 |
| 1985年 | 4月 | 开始COB制程生产 |
| 1988年 | 5月 | 开始CHIP生产 |
| 1989年 | 5月 | 第三栋大楼竣工并开始营运 |

1989

1990

- | | | |
|-------|-----|--|
| 1991年 | 1月 | 第4栋大楼竣工并开始营运 |
| | 4月 | Certified RCJ, Registered electronic component认证 |
| 1992年 | 10月 | 开始生产CCD制程 |
| 1993年 | 7月 | 取得ISO9001认证 |
| 1996年 | 8月 | 开始CSP制程生产 |
| 1997年 | 2月 | 开始晶圆背面研磨 |
| 1998年 | 11月 | 开始生产COF |
| 1999年 | 9月 | 取得ISO14001认证 |

1999

2000

- | | | |
|-------|-----|---------------------------|
| 2000年 | 6月 | 增资至3.1亿日元 |
| | 8月 | 第5栋大楼竣工并开始营运 |
| 2001年 | 10月 | 开始相机模组生产 |
| 2002年 | 11月 | 开始生产IC卡 |
| 2003年 | 5月 | 开发技术中心（旧：矢掛工厂）开始营运 |
| 2006年 | 3月 | 开始One-Seg模块生产 |
| 2007年 | 9月 | 开始晶圆级CSP生产 |
| 2008年 | 8月 | SAIGON STEC（100%子公司）开始营运 |
| | 10月 | 开始相机元件生产 |
| 2009年 | 3月 | 开始生产太阳能组件
取得ISO27001认证 |

2009

2010

- | | | |
|-------|-----|---|
| 2012年 | 10月 | 开始触控面板模组组装生产 |
| 2014年 | 6月 | 矢掛太阳能发电站开始营运 |
| 2015年 | 5月 | 总部太阳能发电厂开始运作 |
| | 9月 | 停止生产IC卡 |
| | 10月 | 取得ISO/TS16949认证 |
| 2018年 | 5月 | 将SAIGON STEC 51%的股份转让给SHARP Corporation |
| 2019年 | 7月 | 雷达模块生产开始 |
| 2020年 | 3月 | 从SHARP Corporation获得全部SHARP TAKAYA股份 |
| | 6月 | 资本额变更为1亿日元 |
| 2021年 | 3月 | 開発技术中心（旧：矢掛工厂）与总公司统合，并归还TAKAYA Corporation |
| | 6月 | 医疗机器制造业登录 |
| | 10月 | 公司名称由“Sharp Takaya ELECTRONICS INDUSTRY CO.,LTD.”变更为S-TAKAYA ELECTRONICS INDUSTRY CO.,LTD.” |
| 2022年 | 12月 | mold package（lead frame产品）生产停止 |
| 2023年 | 8月 | 获得笠冈地区消防组合救Mark认定事业所的认证 |
| 2024年 | 1月 | 获得SPORTS YELL COMPANY 2024年认证 |
| | 3月 | 获得健康经营优良法人2024（大规模法人部门）认证 |
| | 5月 | POWER半导体生产开始 |